

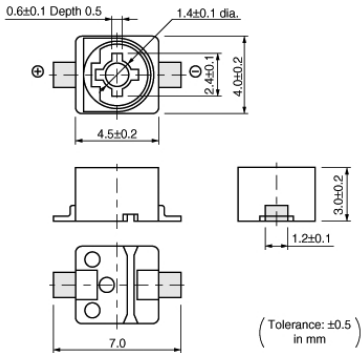
TZB4Z250BB10B00

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



特点

1. Miniature rectangular shape: 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm.
2. Color coded case facilitates identification of capacitance range.
3. Designed for automatic placement in surface mount applications.
4. Designed to withstand flux baths and solder baths (with cover film type).
5. Can be temporarily attached to PCB with adhesives (Terminal style A and B).
6. Can be reflow and flow (with cover film type) soldering method.
7. Stable characteristics over a wide frequency range. (Resonant frequency: 1000MHz min. / 6pF)

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B00	散装袋	500

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TZB4Z250BB10B00

规格

形状	SMD
工作温度范围	-25°C to 85°C
厚度	3mm
厚度公差	±0.2
额定电压	50Vdc
静电容量最小值(max.)	4pF
静电容量最大值	25pF
静电容量最大值公差	+100/-0%
调整方向	上方
温度特性	NP0±300ppm/°C
Q	300min. at 1MHz, Cmax.
耐电压	110Vdc
绝缘电阻(min.)	10000MΩ
力矩	1.5 to 9.8mNm
定子/外壳颜色	Black+Marking
质量	0.15g

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

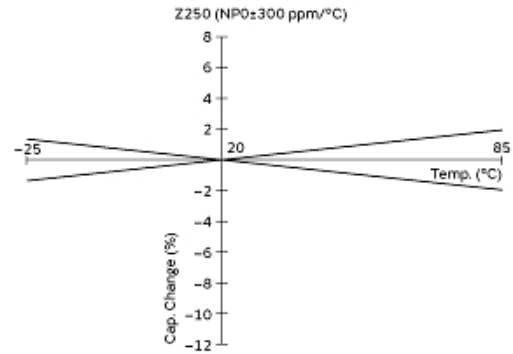
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TZB4Z250BB10B00

产品数据



结构



温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请确认其规格或者办理产品规格表。